【裁判字號】104,行專訴,61
【裁判日期】1041203
【裁判案由】新型專利舉發
【裁判全文】
智慧財產法院行政判決

104 年度行專訴字第 61 號

原　　告　鴻騏新技股份有限公司
代　表　人　黃小燕
訴訟代理人　陳家輝律師（兼送達代收人）
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　文治中
　　謝文元
參　加　人　技高工業股份有限公司
代　表　人　黃銘玉
訴訟代理人　彭志弘(專利代理人)

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國 104 年 4 月 24 日經訴字第 10406305760 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主文

原處分關於「請求項 6 舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷。

被告應就公告號第 M428354 號「多聯板檢測裝置」新型專利請求項 6 部分為舉發成立，應予撤銷之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：參加人前於民國 100 年 12 月 20 日以「多聯板檢測裝置」向被告申請新型專利，請求項共計 7 項，經被告編為第 100223960 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M428354 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於 101 年 9 月 28 日以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，向被告提起舉發。參加人旋於 103 年 4 月 3 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被告審查，認該更正本符合處分時專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 2 項及第 4 項之規定，應准予更正。更正後請求項實際計有 6 項（請求項序號未變，第 2 項刪除），本件舉發案依該更正本審查。經被告審查，認系爭專利請求項 2 業因更正刪除，系爭專利請求項 1、3 至 5、7 違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定及第 7 項違反同條第 4 項規定，惟系爭專利請求項 6 並未違反上開規定，乃以 103 年 10 月 24 日(103)智專三(二)04206 字第 10321483260 號專利

舉發審定書為「103 年 4 月 3 日之更正事項，准予更正。請求項 1、3 至 5、7 舉發成立應予撤銷。請求項 6 舉發不成立。請求項 2 舉發駁回」之處分。原告就「請求項 6 舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願，經經濟部以 104 年 4 月 24 日經訴字第 10406305760 號為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定及原處分關於請求項 6 舉發不成立之部分，被告應就系爭專利舉發事件為請求項 6 舉發成立應予撤銷之審定。本院認本件判決之結果，若認定應撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分關於系爭專利請求項 6 舉發不成立之部分，被告應就系爭專利舉發事件為請求項 6 舉發成立應予撤銷之審定，並主張：

(一)證據 2 可以證明系爭專利請求項 6 不具新穎性和進步性：

1.系爭專利請求項 6 係依附第 5 項，且間接依附請求項 1，然其所記載者僅為元件「處理模組」所進行的判斷、處理資料的程序，對於「處理模組」本身或其他「輸送模組」、「擷取模組」等元件或其間之連接關係，不會產生改變或影響，因此，依智慧財產法院 102 年度行專訴字第 82 號、101 年度行專訴字第 82 號判決之闡釋，應認為系爭專利請求項 6 之記載非屬結構特徵，其僅得視為習知技術之運用，準此，由於證據 2 之說明書及圖式 1、7 所揭露之「檢知裝置 1」與一加工設備即「取置機台 40」連接、將多聯板送進取置機台 40 的「輸送帶」、用來擷取所輸送多聯板的特徵的「擷取模組」，以及用以接收多聯板之影像並利用影像分析軟體依序檢視多聯板上之子板影像之「運算單元 20」等技術內容，已得對應於系爭專利所記載「多聯板檢測裝置」、「輸送模組」、「擷取模組（影像擷取元件）」、「處理模組」、「影像特徵資料庫」等技術特徵，故證據 2 已揭露系爭專利請求項 6 所有結構特徵，當認定系爭專利請求項 6 不具進步性。

2.縱使（非原告自認）認為系爭專利請求項 6 所記載者屬結構特徵，仍已被證據 2 所揭露或僅屬於通常知識，為所屬技術領域中具有通常知識者得輕易完成者，當不具進步性：

(1)雖原處分理由稱「因證據 2 之複數多聯板之間並無明確揭示具有生產型號或加工類型的區別。」，然如證據 1 即系爭專利說明書第 7 頁第 8 至 9 行所記載「另言之，待加工多聯板 4 通常具有用以表示生產型號或加工類型的特徵」，亦即由系爭專利說明書之實施方式所記載，可知參加人亦認定多聯板具有用以表示生產型號或加工類型的特徵，應屬於通常知識，被告前揭審定理由，顯屬錯誤。

(2)又證據 2 說明書第 11 頁第 6 至 12 行、第 12 頁第 2 至 15 行揭露之技術內容，已明確記載證據 2 之運算單元 20 可根據已所設定之多

聯板參數及檢知參數，對多聯板的完整影像進行分析，且該等多聯板參數包括多聯板的「尺寸」、「規格」等，因此，自包括「生產型號」或「加工類型」，是以，證據 2 實際上已經揭露系爭專利請求項 6 前段所記載：「該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序」之技術特徵。

(3)再者，證據 2 說明書第 12 頁第 20 至 24 行、第 13 頁第 12 至 16 行、第 17 頁第 4 至 9 行揭露之技術內容更已明確記載證據 2 之取置機台 40 可藉由檢知裝置 1 之運算單元 20 所提供的檢知資料來作調整，再進行元件置件，且檢知資料至少包括「不良品標記」、多聯板之「尺寸」及「規格」、對應多聯板材質之「偏移量補償」等對應於多聯板「生產型號」或「加工類型」之基本資訊，是以，證據 2 實際上已經揭露了系爭專利更正後請求項 6 後段所記載「而據以調整各該加工設備的執行程式」之技術特徵，並得達成加工設備產能提高的技術功效。

(4)證據 2 說明書揭露「該運算單元 20 的其他模組在於進行產品的選擇或系統調整等功能」之技術特徵，對於所屬技術領域中具有通常知識者提供充分的動機與教示，可藉由證據 2 所揭露之運算單元 20 來根據多聯板產品之不同特徵，判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整加工設備的執行程式。

3.綜上，可知被告僅因證據 2 未揭露如系爭專利「多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型」等文字，而認定證據 2 未揭露系爭專利請求項 6 之技術特徵，惟實際上，系爭專利請求項 6 之記載非屬結構特徵，僅得視為習知技術之運用，自不具進步性。縱認系爭專利請求項 6 所附加之技術特徵，得改變或影響多聯板檢測裝置之結構，然因證據 2 已揭露運算單元 20 可根據多聯板尺寸、規格、材質等實質上對應於生產型號或加工類型之多聯板特徵來產生檢知資料，而調整加工設備即取置機台 40 進行置件之技術內容，況且，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，待加工多聯板 4 具有用以表示生產型號或加工類型的特徵，係屬通常知識，故自得根據證據 2 所揭露之先前技術，而輕易完成系爭專利請求項 6 記載之全部技術特徵，應當認定系爭專利請求項 6 不具進步性。

(二)依上所陳，系爭專利請求項 6 之附加技術特徵，非屬結構特徵，應視為習知技術之運用，且證據 2 已揭露與系爭專利請求項 6 實質相同的技術內容，況且待加工多聯板 4 具有用以表示生產型號或加工類型的特徵，僅係屬通常知識，在系爭專利請求項 1、3 至 5 項不具新穎性的情況下，所屬技術領域中具有通常知識者，當得依證據 2 所揭露之先前技術內容，而輕易完成系爭專利請求項 6 之技術手段，應認定系

爭專利請求項 6 之技術手段整體不具進步性，違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，應予撤銷。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)原告於本件訴訟時另行提出於舉發及訴願階段所未主張之系爭專利請求項 6 之記載非屬結構特徵，該主張前後不一致的情況下，可佐證原處分並無違誤，然為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，故被告仍對原告另行所提出之主張予以答辯，合先敘明。

(二)就系爭專利請求項 6 所揭露之附屬技術特徵，在結構上的改變而言，於多聯板上需具有生產型號或加工類型之標示，用以使處理模組自動辨識多聯板的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式，簡言之，系爭專利請求項 6 之多聯板包含用以使處理模組辨識生產型號或加工類型之標示或特徵，處理模組得依該特徵判斷多聯板被預定的加工處理程序，針對不同生產型號或加工類型之多聯板立即調整加工設備之執行程式之技術特徵，換言之，系爭專利請求項 6 之處理模組係一具有根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序而據以調整各該加工設備的執行程式功能之特定處理模組，其為具有一特定之構造上結構特徵之處理模組，故系爭專利請求項 6 之記載難謂非屬結構特徵。

(三)依證據 2 說明書第 11 頁第 8 至 10 行、第 12 頁第 8 至 13 行、第 13 頁第 12 至 16 行、第 15 頁第 2 至 6 行所記載之技術特徵，證據 2 係揭示使用者事先於參數設定模組 205 設定多聯板的尺寸規格，用以使運算單元定義檢知區域，以正確地找出不良品標記及定位標靶的位置，供後續置件製程或偏移補償量等程序中利用，換言之，證據 2 揭示的參數設定模組 205 係由使用者於生產前先設定尺寸的參數再進行加工作業，若要再進行另一種產品的加工，則必須停下生產線作業，以人工設定好另一組多聯板尺寸參數，是以，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 6 之「該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式」之附屬技術特徵。

(四)縱使系爭專利之多聯板具有用以表示生產型號或加工類型的特徵屬通常知識，然系爭專利請求項 6 之「處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進行該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式」之技術特徵未揭示於證據 2 中，非屬通常知識，原處分自無違誤。

(五)證據 2 揭示使用者所事先於參數設定模組 205 設定多聯板的尺寸規格，是用來使運算單元定義檢知區域，以正確地找出不良品標記及定位標靶的位置，供後續置件製程或偏移補償量等程序中利用，況且尺寸規

格與生產型號或加工類型係屬明顯不同概念，是以，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 6 之之技術特徵。

(六)證據 2 說明書第 12 頁第 20 至 24 行僅說明該發明之取置機台 40 可以經由該運算單元 20 獲得檢知資料，該檢知資料可記錄有該多聯板上之子板的優劣情況，該取置機台並可依據該檢知資料進行置件的作業，證據 2 說明書第 13 頁第 12 至 16 行、說明書第 17 頁第 4 至 9 行僅說明該發明之子板 301 設有定位標靶，以決定所需要的偏移補償量，該多聯板之標記的檢知裝置 1 亦可以利用定位標靶的位置分析每一子板 301 的偏移量，並將其儲存於檢知資料中，而該取置機台 40 則可以根據檢知資料中的紀錄先進行偏移量的補償之技術內容，證據 2 並未揭示「根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型以調整各該加工設備的執行程式」，故證據 2 並未揭示系爭專利請求項 6 之「據以調整各該加工設備的執行程式」。

(七)證據 2 並未揭示「根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型以調整各該加工設備的執行程式」，故證據 2 並未揭示系爭專利請求項 6 之「據以調整各該加工設備的執行程式」。

(八)系爭專利請求項 6 之記載難謂非屬結構特徵，且系爭專利請求項 6 之技術特徵非為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2 所揭露之使用者事先於參數設定模組 205 設定多聯板的尺寸規格，用以使運算單元定義檢知區域，以正確地找出不良品標記及定位標靶的位置，供後續置件製程或偏移補償量等程序中利用之技術內容，所能輕易完成，故系爭專利請求項 6 未違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

(一)系爭專利請求項 6 係依附請求項 5，並間接依附請求項 1，請求項 1 界定「擷取模組，位於該輸送模組上方，用來擷取該輸送模組所輸送多聯板的特徵」，而請求項 6 進一步界定「該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，調整各該加工設備的執行程式」，亦即，系爭專利請求項 6 係界定處理模組係根據來自於擷取模組對位於輸送模組上方多聯板擷取的多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，調整各該加工設備的執行程式，由此可知，系爭專利請求項 6 係界定有「處理模組」、「擷取模組」與「輸送模組」的結構特徵間的相互關係與影響，也就是說，系爭專利請求項 6 項之「該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，調整各該加工設備的執行程式」係為說明處理模組本身與擷取模組、輸送模組結構特徵間的關係。依專利法審查基準第五篇舉發審查的 4.3.1.3 節可知，先前技術若未揭露系爭專利請求項 6 的所有特徵，就無法據以認定系爭專利請求項 6 不具進步性。

(二)一般而言，不同生產型號或加工類型的多聯板，會有著不同的加工參

數（例如、電路佈局及電子元件置件位置），因此，若要改變加工多聯板的種類（即改變加工多聯板的生產型號或加工類型），就必需要停下生產線作業，以人工重新設定將要生產的多聯板的加工參數，方可重新啟動多聯板的加工作業，如此會衍生加工效率不佳的問題。對此，系爭專利請求項 6 提出一種生產系統，可依據「多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型」，立即將生產線調整為針對另一種產品進行加工作業的技術，而毋須停下生產線，可有效提升加工效率，而可解決現今產線的效率問題。同時參照證據 2 說明書第 13 至 14 頁所揭露之技術特徵，可知，證據 2 主要係揭露使用者在對每種多聯板進行加工前，需要先透過人力（即人工）於參數設定模組 205 中設定加工多聯板的尺寸，藉以後續對多聯板的每一子板上是否有不良品標記進行判定，且證據 2 的檢知裝置僅能將由不良品標記獲得的檢知資料提供給取置機台，如證據 2 表 1 所示，證據 2 的檢知資料僅列示不良品標記的檢知結果，此檢知結果與多聯板的生產型號或加工類型無關。因此，證據 2 實未揭露系爭專利請求項 6 之「根據多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷多聯板被預定的加工處理程序」的特徵。且證據 2 揭露之參數設定模組 205 係由使用者於生產前先以人工設定多聯板的尺寸參數後再進行加工作業，若要再進行另一種多聯板的加工，則必須停下生產線作業，再以人工設定好另一種多聯板的尺寸參數，方可啟動加工作業，此乃習知的加工作業模式。相較之下，系爭專利請求項 6 之處理模組根據多聯板特徵，判斷多聯板的生產型號或加工類型，進而主動適應性調整各該加工設備的執行程式，而可在線上更換加工多聯板的種類，即毋須停下生產線作業，就可對另一種多聯板進行加工，因而，證據 2 與系爭專利請求項 6 的技術思想與所能達成的技術功效明顯不同，證據 2 無法據以認定系爭專利請求項 6 不具進步性。

五、得心證之理由：

(一)按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第 93 條暨第 94 條第 1 項前段所規定。惟如新型「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成」者，仍不得依法申請取得新型專利，同法第 94 條第 4 項復有明文。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法規定之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違反前揭專利法之規定者，自應為舉發不成立之處分，反之，則應為舉發成立之處分。

(二)系爭專利係於 100 年 12 月 20 日申請，並經被告於 101 年 2 月 22 日審

定核准，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之 99 年 9 月 12 日修正公布之專利法（下稱 99 年專利法）為斷。本件原處分係為「103 年 4 月 3 日之更正事項，准予更正。請求項 1、3 至 5、7 舉發成立應予撤銷。請求項 6 舉發不成立。請求項 2 舉發駁回」之處分，參加人未就原處分不服，提起訴願，而原告就「請求項 6 舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願，經經濟部為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定及原處分關於請求項 6 舉發不成立之部分，被告應就系爭專利舉發事件為請求項 6 舉發成立應予撤銷之審定。是以，本件之爭點在於：系爭專利請求項 6 是否有違反 99 年專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定？

(三)系爭專利之技術分析：

1. 系爭專利所屬技術領域係關於一種檢測裝置，特別指一種用於與置件機連接的多聯板（PCB Panelization）檢測裝置（BSK）。所提供之多聯板檢測裝置，係用於與加工設備連接，以檢測具有多個電路基板的多聯板，包括有輸送模組、擷取模組以及處理模組，該輸送模組係用來輸送多聯板至加工設備，擷取模組位於該輸送模組上方，用來擷取多聯板的特徵，該處理模組可將該多聯板特徵傳遞予該加工設備接收，或命令該輸送模組將多聯板送至多個加工設備中之最適者，使該加工設備可依據該多聯板特徵對該多聯板進行加工處理。如此，不必依靠人工，減少時間浪費，也可透過特徵的擷取，將多聯板輸送到適當的加工設備加工，而達成多聯板加工生產線的分流，俾提升多聯板的加工效率。爭專利所欲解決的技術問題為：對於生產者而言，若每次僅生產單一的小型電路基板，未免過於浪費，不符產業的需求。為此，即有併板生產的模式產生，將多個同型的小型電路基板合併為單一的大型電路板，以提高生產價值，此大型電路板即為習稱的多聯板（PCB Panelization）。然而，對於前述的多聯板，即使製程、品管如何發達，其上的電路基板也不可能達成百分之百的良率。若在不良電路基板作加工或零件的置放，將造成成本的浪費，或生產時間的增加。尤其是對於昂貴的電子零件，則損失更是難以估計。系爭專利主要目的為提供一種多聯板檢測裝置，係與加工設備連接，以傳遞多聯板特徵予加工設備接收，加工設備得據以對多聯板進行合適的加工處理，因而不必依靠人工判斷，如此可減少時間浪費與避免人為疏失。另一目的乃在提供一種多聯板檢測裝置，係能找出良品的電路基板，以跳過對不良品電路基板的加工，而簡化加工程序。又一目的乃在提供一種多聯板檢測裝置，係能將多聯板輸送到多部加工設備中的最適者加工，而達成加工分流的效果，俾提升多聯板的加工效率。再一目的乃在提供一種多聯板檢測裝置，可根據多聯板的檢測結果，調整加工設備的執行程式，而對多聯板實施最合適的加工程序。系爭專利為達成上述目

的之技術手段為：多聯板檢測裝置，係用於與加工設備 3（例如置件機）連接，以對具有多個電路基板 41 的多聯板 4 執行檢測，包括：輸送模組 1，用來輸送該多聯板至該加工設備；擷取模組 2，位於該輸送模組上方，用來擷取該輸送模組所輸送多聯板的特徵；以及處理模組 5，係分別連接該擷取模組與加工設備，以接收該擷取模組所擷取的多聯板特徵，並將該多聯板特徵傳遞予該加工設備接收，使該加工設備可依據該多聯板特徵對該多聯板進行加工處理，系爭專利主要圖式如附件一所示。

2.系爭專利申請專利範圍分析：

依原核准公告申請專利範圍所載請求項共計 7 項，參加人於 103 年 4 月 3 日更正刪除請求項 2，並將說明書記載之技術更正限縮至請求項 1、5、6、7，經被告審查核准並於 103 年 11 月 21 日公告。本件原告爭執之請求項 6 內容，其按依附於請求項 5,4,3 順序而依附請求項 1，其有關之內容如下：

第 1 項：一種多聯板檢測裝置，係用於與加工設備連接，以對具有多個電路基板的多聯板執行檢測，包括：輸送模組，用來輸送該多聯板至該加工設備；擷取模組，位於該輸送模組上方，用來擷取該輸送模組所輸送多聯板的特徵；以及處理模組，係分別連接該擷取模組與加工設備，以接收該擷取模組所擷取的多聯板特徵，而根據所接收的多聯板特徵判斷該多聯板各電路基板是否為良品，並將該多聯板特徵傳遞予該加工設備接收，使該加工設備可依據該多聯板特徵對該多聯板進行加工處理。

第 3 項：如申請專利範圍第 1 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該擷取模組係具有影像擷取元件，係面對該輸送模組而設置，以擷取所輸送之多聯板的影像特徵。

第 4 項：如申請專利範圍第 3 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該處理模組係與影像特徵資料庫連接，該影像特徵資料庫儲存有該多聯板各位置電路基板之良品影像特徵。

第 5 項：如申請專利範圍第 4 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該處理模組係透過該影像特徵資料庫判斷該多聯板各位置的電路基板是否為良品，使該加工設備可跳過對不良品電路基板的加工，僅對各該良品電路基板進行加工處理。

第 6 項：如申請專利範圍第 5 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式。

(四)舉發證據之技術分析：

證據 2 為 99 年 4 月 16 日公開之我國專利第 201015062 號「多聯板之標記的檢知方法、檢知裝置及多聯板的置件方法」專利案，其公開之日期早於系爭專利申請日(100 年 12 月 20 日)，可執為系爭專利核准審定時所適用之 99 年 9 月 12 日施行之專利法第 94 條第 4 項的先前技術。證據 2 係關於一種多聯板之標記的檢知方法，尤指一種完整擷取多聯板影像再加以分析多聯板上之子板的不良品標記、或多聯板上的定位標靶之檢知裝置方法，並將其檢知結果之資訊傳遞給後方之生產機台者，其主要圖式如附件二所示。如證據 2 第一圖所示為其發明之多聯板之標記的檢知裝置 1 之示意圖，其中該多聯板之標記的檢知裝置 1 包括一影像擷取單元 10 以及一運算單元 20，其中該影像擷取單元 10 具有一預定解析度及一預定放大倍率且在一預定工作距離（working distance）WD 下擷取該多聯板 30 之影像。另外該多聯板之標記的檢知裝置 1 可搭配一取置機台 40，實際上該取置機台 40 可為晶片取置機或打線機，如 die bonder 等其他可用以進行晶片取置或線路連接的機台或設備（例如應用在 BGA 的封裝製程，可生產 MICRO－SD、DDRII 等產品)，而該取置機台 40 可以經由該運算單元 20 獲得檢知資料，該檢知資料可記錄有該多聯板上之子板的優劣情況，該取置機台 40 並可依據該檢知資料進行置件的作業。又如證據 2 第二圖所示，其為一種多聯板 30 態樣之示意圖，其包括複數個子板 301，該些子板 301 在經過一定的判別步驟後便會被區分為良品及不良品，而屬於不良品的子板 301 就會以不良品標記（bad mark）31 的方式標示之，該標記的檢知裝置 1 即能快速的檢知上述的不良品標記 31，使取置機台 40 可以根據該標記的檢知裝置 1 所得到的檢知資料針對屬於良品的子板 301 進行置件，即取置機台不會將元件設置於不良的子板 301 上，進而達成節省材料的功效。

(五)證據 2 足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性：

1.依據現行專利法第 149 條第 2 項規定：「本法中華民國 100 年 11 月 29 日修正之條文施行前，尚未審定之專利更正案及舉發案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定。」。查本件系爭專利之舉發提起日為 101 年 9 月 28 日，舉發審定日為 103 年 10 月 24 日，本件為新型專利，故關於新型定義及其是否具備進步性之判斷，應參酌配合現行專利法之舉發審查基準。參酌 2014 年版舉發審查基準第 5-1-24 頁係規定：「新型專利係保護利用自然法則之技術思想具體表現於物品之形狀、構造或組合之創作，惟新型專利實體要件之審查應就請求中所載之全部技術特徵為之。新型請求項之新穎性審查，單一先前技術必須揭請求中所載之全部技術特徵，包括結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法），始能認定不具新穎性。然而，新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否

會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。」。

2.次查，爭專利請求項 6 按依附於請求項 5,4,3 順序而依附請求項 1，故系爭專利請求項 6 之實質內容係包含請求項 1、3 至 5 所記載的內容。又系爭專利請求項 1 係「一種多聯板檢測裝置，係用於與加工設備連接，以對具有多個電路基板的多聯板執行檢測，包括：輸送模組，用來輸送該多聯板至該加工設備；擷取模組，位於該輸送模組上方，用來擷取該輸送模組所輸送多聯板的特徵；以及處理模組，係分別連接該擷取模組與加工設備，以接收該擷取模組所擷取的多聯板特徵，而根據所接收的多聯板特徵判斷該多聯板各電路基板是否為良品，並將該多聯板特徵傳遞予該加工設備接收，使該加工設備可依據該多聯板特徵對該多聯板進行加工處理。」、請求項 3 係「如申請專利範圍第 1 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該擷取模組係具有影像擷取元件，係面對該輸送模組而設置，以擷取所輸送之多聯板的影像特徵。」、請求項 4 係「如申請專利範圍第 3 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該處理模組係與影像特徵資料庫連接，該影像特徵資料庫儲存有該多聯板各位置電路基板之良品影像特徵。」、請求項 5 係「如申請專利範圍第 4 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該處理模組係透過該影像特徵資料庫判斷該多聯板各位置的電路基板是否為良品，使該加工設備可跳過對不良品電路基板的加工，僅對各該良品電路基板進行加工處理。」、請求項 6 係「如申請專利範圍第 5 項所述的多聯板檢測裝置，其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式。」。亦即，系爭專利請求項 6 的實質內容為：「一種多聯板檢測裝置，係用於與加工設備連接，以對具有多個電路基板的多聯板執行檢測，包括：輸送模組，用來輸送該多聯板至該加工設備；擷取模組，位於該輸送模組上方，用來擷取該輸送模組所輸送多聯板的特徵；以及處理模組，係分別連接該擷取模組與加工設備，以接收該擷取模組所擷取的多聯板特徵，而根據所接收的多聯板特徵判斷該多聯板各電路基板是否為良品，並將該多聯板特徵傳遞予該加工設備接收，使該加工設備可依據該多聯板特徵對該多聯板進行加工處理；其中，該擷取模組係具有影像擷取元件，係面對該輸送模組而設置，以擷取所輸送之多聯板的影像特徵；其中，該處理模組係與影像特徵資料庫連接，該影像特徵資料庫儲存有該多聯板各位置電路基板之良品影像特徵；其中，該處理模組係透過該影像特徵資料庫判斷該

多聯板各位置的電路基板是否為良品，使該加工設備可跳過對不良品電路基板的加工，僅對各該良品電路基板進行加工處理；其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式。」。

3.系爭專利請求項 6 與證據 2 之技術特徵比對：

(1)關於系爭專利請求項 6 實質內容中依附於請求項 1、3 所進一步界定之技術特徵，證據 2 在第一圖所示之實施例及對應的說明書內容揭露：「…第一圖，其為本發明之多聯板之標記的檢知裝置 1 之示意圖，其中該多聯板之標記的檢知裝置 1 包括一影像擷取單元 10 以及一運算單元 20，其中該影像擷取單元 10 具有一預定解析度及一預定放大倍率且在一預定工作距離（working distance）WD 下擷取該多聯板 30 之影像。…」、「…本發明所提出之影像擷取單元 10 之影像解析度（Image Resolution）可為 768x576 畫素（pixel），搭配鏡頭所形成的空間解析度（Spatial Resolution）可為 0.25 至 0.5 公厘／畫素（mm／pixel），…該影像擷取單元 10 更進一步包括複數個發光單元 101，以提供該影像擷取單元 10 最佳的照明情況，…」、「…多聯板之標記的檢知裝置 1 之運算單元 20 則用以接收該多聯板 30 之影像並利用影像分析軟體依序檢視該多聯板 30 上之子板 301 的影像。…」、「…多聯板之標記的檢知裝置 1 可搭配一取置機台 40，實際上該取置機台 40 可為晶片取置機或打線機，如 die bonder 等其他可用以進行晶片取置或線路連接的機台或設備…而該取置機台 40 可以經由該運算單元 20 獲得檢知資料，該檢知資料可記錄有該多聯板上之子板的優劣情況，該取置機台 40 並可依據該檢知資料進行置件的作業。」、「…上述的多聯板之標記的檢知裝置 1 均是設置在取置機台 40 外側，亦即多聯板 30 係先經過多聯板之標記的檢知裝置 1 檢知之後再藉由輸送帶等裝置送進取置機台 40 進行製程。…」。又如證據 2 第一圖所示，運算單元 20 分別連接影像擷取單元 10 與取置機台 40，影像擷取單元 10 面對且位於多聯板 30 上方。

(2)由上述證據 2 揭露之內容之「多聯板之標記的檢知裝置 1」、「取置機台 40」、「子板 301」、「多聯板 30」、「輸送帶」、「影像擷取單元 10、鏡頭及發光單元 101」及「運算單元 20」可分別對應於系爭專利請求項 6 實質內容中「多聯板檢測裝置」、「加工設備」、「多個電路基板」、「多聯板」、「輸送模組」、「擷取模組」及「處理模組」。故系爭專利請求項 6 實質內容中，依附於請求項 1 所記載「一種多聯板檢測裝置（對應於證據 2 之多聯板之標記的檢知裝置 1），係用於與加工設備連接（對應於證據 2 之取置機台 40），以對具有多個

電路基板（對應於證據 2 之子板 301）的多聯板（對應於證據 2 之多聯板 30）執行檢測，包括：輸送模組（對應於證據 2 之輸送帶），用來輸送該多聯板至該加工設備；擷取模組（對應於證據 2 之影像擷取單元 10、鏡頭及發光單元 101），位於該輸送模組上方，用來擷取該輸送模組所輸送多聯板的特徵；以及處理模組（對應於證據 2 之運算單元 20），係分別連接該擷取模組與加工設備，以接收該擷取模組所擷取的多聯板特徵（對應於證據 2 第 11 頁第 23 行至第 12 頁第 1 行所述），而根據所接收的多聯板特徵判斷該多聯板各電路基板是否為良品，並將該多聯板特徵傳遞予該加工設備接收，使該加工設備可依據該多聯板特徵對該多聯板進行加工處理（對應於證據 2 第 12 頁第 16 至 23 行所述）。」，以及依附於請求項 3 所進一步界定「其中，該擷取模組係具有影像擷取元件（對應於證據 2 之影像擷取單元 10），係面對該輸送模組而設置，以擷取所輸送之多聯板的影像特徵。」之所有技術特徵已為證據 2 所揭示。

(3)關於系爭專利請求項 6 實質內容依附於請求項 4,5 所進一步界定之技術特徵，參酌證據 2 說明書第 15 頁第 8 行至第 16 頁第 6 行「…該運算單元 20 會先定義一檢知區域 ROI 對應該編號 1 的子板 301，而該運算單元 20 即可判讀出該編號 1 的子板 301 上是否設有不良品標記 31…最後即可輸出一檢知資料給後端的取置機台 40…該取置機台 40 即可應用該檢知資料進行每一子板 301 的置件程序，例如該取置機台 40 並不會對歸類為不良品的子板 301 進行後續的置件作業…」、第 17 頁第 21 至 23 行「…每一生產線上的取置機台 40 可以連接至該資料庫單元 50 以得知待作業之多聯板 30 上的不良品子板 301 的位置，以正確的進行後端製程，…」、第 10 頁第 17 至 20 行「…使取置機台 40 可以根據該標記的檢知裝置 1 所得到的檢知資料針對屬於良品的子板 301 進行置件，即取置機台不會將元件設置於不良的子板 301 上…」之記載以及第七圖所示（檢測裝置 1 與資料庫 50 連接）內容，可知：運算單元 20 比對多聯板 3 各子板檢知區域 ROI 是否設有不良品標記 31，最輸出一檢知資料給資料庫單元 50；取置機台 40 係與資料庫單元 50 連接，以得知不良品子板 301 的位置，並僅針對屬於良品子板 301 進行置件，而不會對不良的子板 301 進行置件。是以，由上述證據 2 內容中之「資料庫單元 50」及「ROI 區域無不良品標記之影像特徵」可對應於系爭專利請求項 6 實質內容中之「影像特徵資料庫」及「良品影像特徵」，即系爭專利請求項 6 實質內容中依附於請求項 4 所進一步界定之「其中，該處理模組係與影像特徵資料庫（對應於證據 2 之資料庫 50）連接，該影像特徵資料庫儲存有該多聯板各位置電路基板之良品影像特徵（對應於證據 2ROI 區域無不良品標記之影像特徵）」以

及依附於請求項 5 所進一步界定之「其中，該處理模組係透過該影像特徵資料庫判斷該多聯板各位置的電路基板是否為良品，使該加工設備可跳過對不良品電路基板的加工，僅對各該良品電路基板進行加工處理（對應於證據 2 第 10 頁第 17 至 20 行所述）」之所有技術特徵亦為證據 2 所揭示。

(4)關於系爭專利請求項 6 實質內容中請求項 6 本身所進一步界定之技術特徵，參酌系爭專利說明書對應實施例，如說明書第 10 頁第 2 至 14 行所記載之「請閱圖五，係為前述多聯板檢測裝置的另一實施步驟流程圖，如圖五所示，本創作之多聯板檢測裝置可藉由處理模組調整加工設備的執行程式，進而加工設備可對各式規格的多聯板進行適應加工。…d1.處理模組透過擷取模組取得待加工多聯板表示生產型號及加工類型的特徵，以獲得待加工多聯板被預定的加工處理程序；e1.根據待加工多聯板的特徵，調整或改變加工設備（例如置件機）的執行程式，以改變加工設備的加工流程，而使加工設備對待加工多聯板執行原先預定的加工處理程序，而對待加工多聯板進行適當的加工。…」之內容可知，系爭專利係利用處理模組透過擷取模組取得加工多聯板生產型號及加工類型的特徵，用以調整或改變加工設備的執行程式。關於證據 2 對於不同多聯板 30 的尺寸規格之取得及目的，由證據 2 說明書第 11 頁第 23 行至第 12 頁第 15 行「而該多聯板之標記的檢知裝置 1 之運算單元 20 則用以接收該多聯板 30 之影像並利用影像分析軟體依序檢視該多聯板 30 上之子板 301 的影像。…運算單元 20 主要具有多種模組，包括一主模組 201；…一與該主模組 201 連接之參數設定模組 205；…又如該參數設定模組 205 包括多聯板參數設定之手段、檢知參數之手段等，該多聯板參數設定之手段可設定待檢知多聯板 30 的尺寸規格，…該運算單元 20 的其他模組在於進行產品的選擇或系統調整等功能，…」、第 13 頁第 24 行至第 14 頁第 6 行「步驟(c)利用該運算單元 20 依序檢知該多聯板 30 之該等子板 301 的影像，以判定每一子板 301 上是否有該不良品標記 31。在此步驟之前，使用者可利用該運算單元 20 中的參數設定模組 205 設定該子板 301 的尺寸，亦即進行一設定該子板 301 尺寸之步驟，以使該運算單元 20 得以根據該子板尺寸依序檢知該多聯板 30 之該等子板 301 的影像。」以及第 14 頁第 23 行至第 15 頁第 12 行「…當檢知步驟開始時，先利用該影像擷取單元 10 擷取該多聯板 30 的完整影像；接著該運算單元 20 會先定義一檢知區域 ROI 對應該最左側端的子板 301（如第五 A 圖）…而該運算單元 20 即可判讀出該最左側下端的子板 301 上設有不良品標記 31，即該最左側下端的子板 301 係屬於不良品。接著，該運算單元 20 會將檢知區域 ROI 依序移動至其他的子板 301

影像上（如第五 B 圖），以判別其他子板 301 上是否有不良品標記 31，最後即可輸出一檢知資料給後端的取置機台 40，該取置機台 40 即可應用該檢知資料進行每一子板 301 的後端製作程序。」之內容，可知使用者必須經過在運算單元 20 之參數設定模組 205 的多聯板參數設定手段所設定待檢知多聯板 30 的尺寸規格的程序後，運算單元 20 方得以根據該子板尺寸依序檢知多聯板 30 內全部子板 301 的影像，並輸出一檢知資料到取置機台 40，供取置機台 40 據以進行每一子板 301 的後端製作程序。再參酌證據 2 說明書第 13 頁第 3 至 15 行「本發明所提出之多聯板之標記的檢知方法，其中包括以下步驟：步驟(a)：提供一多聯板 30，其包括複數個子板 301，其中該等子板 301 中屬於不良品的子板 301 上設有一不良品標記（bad mark）31。…而該等子板 301 更可以是軟板，由於軟板材質的收縮以及軟板尺寸越來越小的情況下，軟板的偏移量就必須加以考慮，故每一子板 301 更設有定位標靶（local fiducial mark），根據定位標靶的位置，以決定所需要的偏移補償量。」、第 17 頁第 4 至 19 行「而如步驟(a)所述，當該等子板 301 為軟板的情況下，該多聯板之標記的檢知裝置 1 亦可以利用定位標靶(local fiducial mark）的位置分析每一子板 301 的偏移量，並將其儲存於檢知資料中，而該取置機台 40 則可以根據檢知資料中的紀錄先進行偏移量的補償，再進行元件置件的步驟。…」、前述第 13 頁第 24 行至第 14 頁第 15 行指摘步驟(c)等內容可知：每一軟板子板 301 上均設有定位標靶，屬於不良品的軟板子板 301 更設有不良品標記，檢測裝置 1 利用定位標靶分析每一軟板子板 301 的偏移量以及檢知有無不良品標記，以供取置機台進行偏移量的補償及元件置件等作業。是以，證據 2 雖揭示運算單元使用多聯板的尺寸規格之技術，然其係由使用者經運算單元的參數設定手段而設定於運算單元，且其目的係令運算單元可依序檢知多聯板內全部子板的影像並供取置機台據以進行每一子板的後端製作程序。至於在多聯板子板為軟板的情況下，亦僅揭露可以分析偏移量及檢知有無不良品標記，在未進一步說明的情況下，亦應認其尺寸規格設定方式係相同於上述多聯板子板非為軟板的情況。綜上，對於不同多聯板的尺寸規格之取得及目的，證據 2 所揭示之技術係由使用者設定於運算單元，用以依序檢知多聯板內全部子板的影像並供取置機台進行元件置件偏及移量的補償，明顯不同於系爭專利請求項 6 所記之技術（利用處理模組透過擷取模組取得加工多聯板生產型號及加工類型的特徵，用以調整或改變加工設備的執行程式），故系爭專利請求項 6 實質內容中請求項 6 本身所進一步界定之「其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，

而據以調整各該加工設備的執行程式。」（以下簡稱「未揭示技術特徵」）未為證據 2 所揭示。

(5)針對上述未揭示技術特徵，就各別技術分析如：「其中，該『處理模組』係『根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序』，而據以調整『各該加工設備的執行程式』。」（註：『』為另外加註），再進一步整理為：『處理模組』係經由一判斷步驟所產生的結果而調整『加工設備的執行程式』，該判斷步驟係根據輸入處理模組之『多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型』而輸出相對應之『多聯板被預定的加工處理程序』結果。承上可知，上述未揭示技術特徵係為『處理模組』取得及運用『多聯板被預定的加工處理程序』的方法步驟。再由請求項 6 依附於請求項 3 所進一步界定「其中，該擷取模組係具有影像擷取元件，…以擷取所輸送之多聯板的影像特徵。」可知，上述判斷步驟中的「多聯板特徵」係為影像擷取元件所擷取的「多聯板的影像特徵」屬於影像資料，為兩造及參加人所不爭執（見本院卷第 98 至 99 頁之 104 年 10 月 26 日準備程序筆錄），非為一般簡單的影像比對，客觀上應係由軟體程式進行比對判斷。是以，上述未揭示技術特徵為一以軟體程式執行判斷的方法步驟，核屬非結構特徵。故以下接續判斷上述未揭示技術特徵是否會改變或影響檢測裝置之結構：

①關於「多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型」，由於多聯板特徵係為一影像資料業如前述，故多聯板特徵「所表示的生產型號或加工類型」亦為一影像資料，自不會改變或影響檢測裝置之結構。

②關於「多聯板被預定的加工處理程序」，其係被處理模組所讀取並用以調整「加工設備執行程式」之資訊，亦不會改變或影響檢測裝置之結構。

③關於「加工設備的執行程式」，由系爭專利請求項 1 所記「一種多聯板檢測裝置，係用於與加工設備連接…」可知「加工設備」非為「檢測裝置」的組成構件，則「加工設備的執行程式」，自亦不會改變或影響檢測裝置之結構。

是以，上述未揭示技術特徵（即請求項 6 本身所進一步界定的技術特徵）的各別技術均為非結構特徵，並且均不會改變或影響檢測裝置之結構。

(6)綜上，相較於證據 2，系爭專利請求項 6 包括依附於請求項 1、3、4、5 所界定的技術特徵部分已為證據 2 所揭露，請求項 6 本身所進一步界定的技術特徵為非結構特徵，並且不會改變或影響檢測裝置之結構，依照前開審查基準應認為習知技術之運用，故證據 2 足以

證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

4.被告辯稱系爭專利請求項 6 所記內容：(1)為具有一特定之構造上結構特徵之處理模組難謂非屬結構特徵，且應由一特定之硬體或韌體與處理模組之組合所完成，非單純之軟體所能完成；(2)未為證據 2 所揭露，且非為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2 所揭露之技術內容所能輕易完全，故系爭專利請求項 6 未違反專利法之規定云云。惟查：

(1)參酌 93 年版專利審查基準關於進步性之概念係規定「雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。」（第 2-3-18 頁）。系爭專利請求項 6 本身所進一步界定之技術特徵，未揭露於證據 2 且為非結構特徵，而為發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，業如上述。被告雖認為系爭專利之處理模組在硬體上則實質上必然具有證據 2 處理單元所未具有之硬體架構，可能為一硬體電路、非揮發性儲存裝置所儲存之代碼，然查系爭專利說明書並無相關之記載，即難認被告之理由為可採。縱認系爭專利請求項 6 本身所進一步界定之技術特徵為結構特徵或是會改變影響結構特徵之非結構特徵，然因系爭專利說明書中並未有記載對應之硬體設備，顯見系爭專利發明人認為上述技術特徵所代表的結構特徵，為系爭專利所屬技術領域申請時之通常知識而無需記載於系爭專利說明書中，換言之，以檢測裝置中依據多聯板影像特徵中的生產型號或加工類型而自動調整加工設備程式之硬體設備，乃為系爭專利申請時之通常知識。

(2)關於上開系爭專利請求項 6 之功效，參酌系爭專利說明書對應實施例之說明，係「…本創作的多聯板檢測裝置不必再依靠人工方式進行加工設備程式的調整，可大大減低人為疏失發生的可能。」。經參酌 93 年版專利審查基準記載「改變技術特徵關係之發明，指改變先前技術中之元件形狀、尺寸、比例、位置及作用關係或步驟的順序等之發明。若改變技術特徵關係之發明能產生無法預期的功效或新的用途，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。」（第 2-3-26 頁）。可知將證據 2 所揭示之以人工設定多聯板規格尺寸的技術手段，改變為利用處理模組判斷多聯板影像資料而自動調整加工設備程式之技術手段，為改變技術特徵關係之新型創作，又由於作業過程中減少了人為操作項目，故則可預期能減少人為疏失，即系爭專利請求項 6 就產生之整體功效而言並非無法預期者。

(3)關於動機部分，參酌 93 年版專利審查基準「若申請時的通常知識或先前技術之揭露內容，會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨問題時，轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之

內容而完成申請專利之發明者，應認定該發明不具進步性。」（第2-3-24頁）之規定，可知本件所屬技術領域中具有通常知識者在面臨設定加工設備可能發生疏失或是停機調校等問題時，有合理的動機將證據2所揭示以人工設定多聯板規格尺寸的技術手段，改變為由檢測裝置讀取多聯板影像資料已存在的資訊而自動調整加工設備程式的技術手段，而完成系爭專利請求項6之新型創件。

(4)承上，被告此部分之抗辯尚難採信。

5.本件參加人認為系爭專利請求項6所記載內容係為說明「處理模組」本身與「擷取模組」、「輸送模組」結構特徵間的關係，且與證據2所揭露的技術思想與所能達成的功效明顯不同，故證據2不能證明系爭專利請求項6不具進步性云云。然查：

(1)系爭專利請求項6所進一步界定的技術特徵，為非結構特徵，業如前述。參加人雖謂由系爭專利請求項1所載內容可知該些技術特徵為檢測裝置所界定結構特徵（即「處理模組」、「擷取模組」與「輸送模組」）間的相互關係與影響，然請求項1所界定檢測裝置結構特徵為證據2所揭示，業如上述技術比對，而證據2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，亦經原處分確定在案，且參加人亦不爭執（見本院卷第94至95頁），又參加人所稱「相互關係與影響」於系爭專利說明書中並無對應記載與所界定結構特徵相互關聯的具體形狀、構造，亦尚難認定係屬結構特徵。

(2)參加人所陳「系爭專利可偵測多聯板上的特徵而調整加工機檯內的應用程式，不用停機更改所要生產的多聯板種類」之功效，與前述系爭專利說明書對應實施例所載功效相似，均是由檢測裝置自動調整加工設備程式，則同前理由所述，該等功效並非無法預期者，尚難認非為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。

(3)承上，參加人此部分之抗辯理由亦非可採。

6.關於系爭專利請求項6所界定是屬於結構特徵還是非結構特徵？

(1)經查，依據系爭專利說明書對應於請求項6「處理模組」實施例之記載，如「該處理模組係可根據該多聯板的特徵，調整該加工設備的執行程式。」（系爭專利說明書第5頁第9至10行）、「本創作是提供一種多聯板檢測裝置，係用於與加工設備3（例如置件機）連接，以檢測由多個電路基板41所構成的多聯板4，其主要包含有輸送模組1、擷取模組2與處理模組5。…擷取模組2乃設於多聯板檢測裝置內部輸送模組1的上方，用來對輸送模組1所輸送的待加工多聯板4進行特徵擷取。擷取模組2係可具有影像擷取元件21，影像擷取元件21係例如為CCD（Charge Coupled Device）或CMOS取像元件，乃面對輸送模組1而設置，以擷取輸送模組1上待加工多聯板4的影像特徵。…另言之，待加工多聯板4通常具有用以表

示生產型號或加工類型的特徵，處理模組 5 可透過擷取模組 2 擷取上述特徵，進而判斷待加工多聯板 4 被預定的加工處理程序，而據以調整與其連接後續處理待加工多聯板 4 的加工設備 3 的執行程式，俾使加工設備 3 對待加工多聯板 4 的加工處理能符合需求。是以，本創作之多聯板檢測裝置不必再依靠人工方式對加工設備的執行程式進行調整，故可大大減低人員誤動作與點選時操作時間的延遲」（系爭專利說明書第 6 頁第 11 行至第 7 頁第 13 行）、「請閱圖五，係為前述多聯板檢測裝置的另一實施步驟流程圖，如圖五所示，本創作之多聯板檢測裝置可藉由處理模組調整加工設備的執行程式，進而加工設備可對各式規格的多聯板進行適應加工…d1.處理模組透過擷取模組取得待加工多聯板表示生產型號及加工類型的特徵，以獲得待加工多聯板被預定的加工處理程序；e1.根據待加工多聯板的特徵，調整或改變加工設備（例如置件機）的執行程式，以改變加工設備的加工流程，而使加工設備對待加工多聯板執行原先預定的加工處理程序，而對待加工多聯板進行適當的加工」（系爭專利說明書第 10 頁第 2 至 14 行）之內容可知，適合於系爭利請求項 6 的待加工多聯板具有「用以表示生產型號或加工類型」（下稱「訊息 A」）的特徵，擷取模組擷取「具訊息 A 特徵的多聯板影像特徵」（下稱「影像特徵 B」），處理模組根據影像特徵 B 所表示的訊息 A，獲得多聯板被預定的加工處理程序（下稱「預定程序 C」），據以預定程序 C 調整加工設備的執行程式。惟查，系爭專利說明書中明顯未記載處理模組相對應的結構特徵，亦未記載處理模組與擷取模組及加工設備間彼此關連的結構特徵。是以，無從依據系爭專利說明書所揭露之內容認定其請求項 6 為結構特徵。

(2)被告雖辯稱系爭專利請求項 6 所界定是屬於結構特徵，係依其答辯書理由一：「系爭專利請求項 6…在結構上的改變而言，於多聯板上需具有生產型號或加工類型之標示，…簡言之，系爭專利請求項 6 之多聯板包含用以使處理模組辨識生產型號或加工類型之標示或特徵，處理模組得依該特徵判斷多聯板被預定的加工處理程序，針對不同生產型號或加工類型之多聯板立即調整加工設備之執行程式之技術特徵，換言之，系爭專利請求項 6 之『處理模組』係為一具有根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序而據以調整各該加工設備的執行程式功能之特定處理模組，其為具有一特定之構造上結構特徵之處理模組，故系爭專利請求項 6 之記載難謂非屬結構特徵」之記載，準此，被告認為系爭專利請求項 6 為讀取多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型之標示或特徵，處理模組具有一特定之構造上結構特徵，以根據該標示或特徵而判斷被預定的加工處理程序並調整加工

設備的執行程式。然查，由前述比對理由可知，系爭專利請求項 6 本身所記載「多聯板特徵」係為影像擷取元件所擷取的「多聯板的影像特徵」，並非多聯板上的實體特徵或標示，則處理模組當然是針對多聯板的影像特徵進行讀取判斷並輸出相應的結果，故無被告所稱處理模組具有一特定構造上結構特徵之情事。又查，由被告於言詞辯論期日當庭辯陳：理由「…系爭專利請求項 6 之該處理模組…而據以調整各該加工設備的執行程式，其實質內容即為加工設備具有可立即被處理模組調整為針對不同生產型號或加工類型之多聯板，以進行置件加工之結構及功能，證據 2 並未揭露運算單元 20 得依該特徵判斷多聯板被預定的加工處理程序，更未揭露取置機台 40 具有可立即被運算單元 20 調整為針對不同生產型號或加工類型之多聯板，以進行置件加工過程之結構，證據 2 不足以證明系爭專利不具進步性。」、「系爭專利加工設備，需具有依調整模組針對不同生產型號及加工類型多聯板自動進行置件加工作業之結構，此結構差異，已實質揭示於系爭專利請求項中，證據 2 需以人工輸入，相關尺寸規格，自然不具此種結構。」等語（見本院卷第 121 頁、第 123 頁），係認為系爭專利請求項 6 的實質內容已涵蓋加工設備可立即被處理模組調整之結構及功能，相較於證據 2 具進步性。然查，由前述比對理由可知，「加工設備」並非「檢測裝置」的組成構件，則加工設備所具特別的結構及功能，自與檢測裝置之結構特徵無涉，並且對處理模組而言仍然輸出相應的結果給加工設備，亦難認屬於處理模組之結構特徵，故被告此部分之辯解尚難採信。

(3)參加人雖辯稱「我們認為屬於結構性特徵，…在我們所提簡報第 1 張，處理模組在調整加工設備的執行程式時，需依照擷取模組在輸送設備上的多聯板所擷取的影像作為判斷，如此即表示，系爭專利請求項 6 界定有處理模組、擷取模組及輸送設備間的關係，也包含其結構之間的關係」云云。惟查，參加人所陳仍然是處理模組取得及運用「多聯板被預定的加工處理程序」的方法步驟，且於系爭專利說明書中並無對應記載該等結構特徵彼此間關係的具體形狀、構造，故系爭專利請求項 6 所界定者尚難認係屬結構特徵，故參加人此部分所辯亦難採信。

(4)另查，由證據 2 所揭露內容觀之，如前述比對理由，證據 2 在第 11 頁第 23 行至第 12 頁第 1 行即明確揭示運算單元 20 係以利用影像分析軟體依序檢視多聯板上之子板的影像。又由系爭專利之處理模組相當於證據 2 所揭示之運算單元，且證據 2 足以證明系爭專利請求項 1、3、4、5 不具新穎性，亦已確定在案，且為參加人所不爭執（見本院卷第 94 至 95 頁），足認參加人亦不爭執系爭專利處理模組如同證據 2 之運算單元利用影像分析軟體檢視多聯板影像特徵，

並透過該影像特徵資料庫判斷該多聯板各位置的電路基板是否為良品，自無在系爭專利請求項 6 時分別以硬體及軟體檢視多聯板影像特徵中的「用以表示生產型號或加工類型」及良品／不良品態樣，益證系爭專利請求項 6 為非結構特徵。

六、綜上所述，證據 2 足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性，是以，系爭專利請求項 6 違反 99 年專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定。因此，被告就系爭專利請求項 6 為「舉發不成立」之審定，於法尚有未洽，訴願決定未予糾正，而維持原處分，亦有違誤。從而，原告訴請原處分關於「請求項 6 舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷，以及被告應就系爭公告號第 M428354 號「多聯板檢測裝置」新型專利請求項 6 部分為舉發成立，應予撤銷之審定，即無不合，應予准許。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，原告之訴為有理由，爰依智慧財產法院案件審理法第 1 條，行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中　華　民　國　104　年　12　月　3　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　陳忠行

法　官　熊誦梅

法　官　曾啟謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　華　民　國　104　年　12　月　14　日

書記官　丘若瑤

104 年度行專訴第 061 號附件

附件一：

系爭專利圖一為創作之系統配置示意圖。

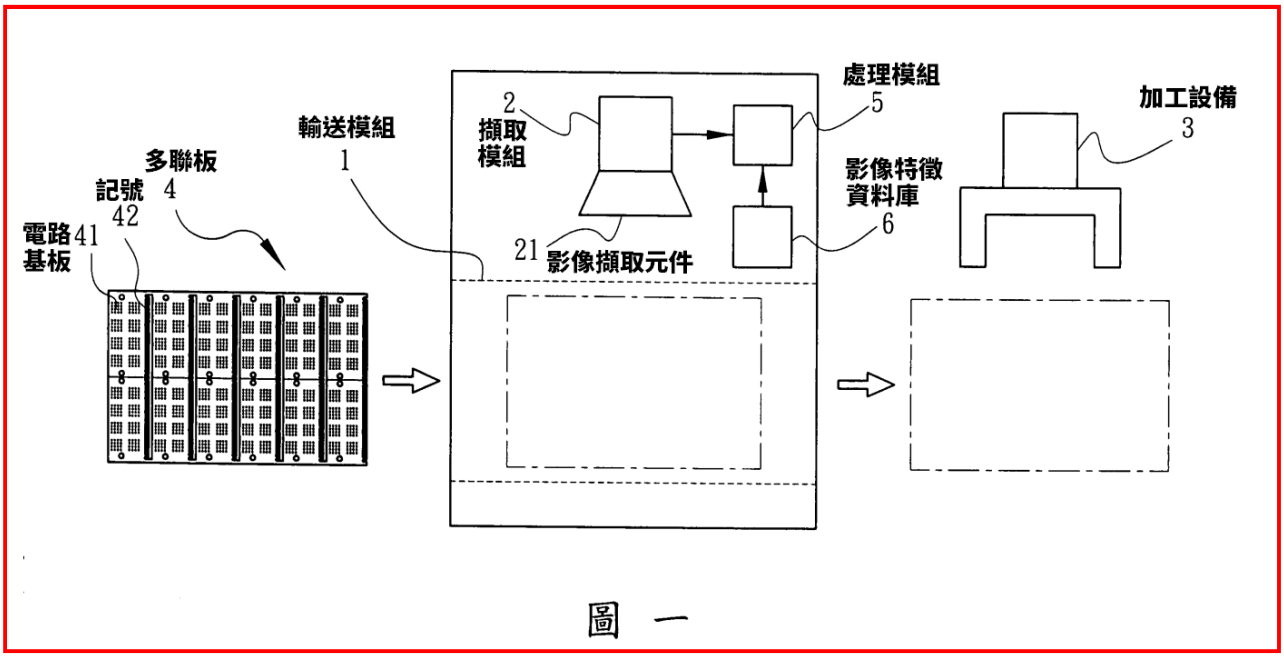


圖 一

系爭專利圖三為不良品多聯板的示意圖。

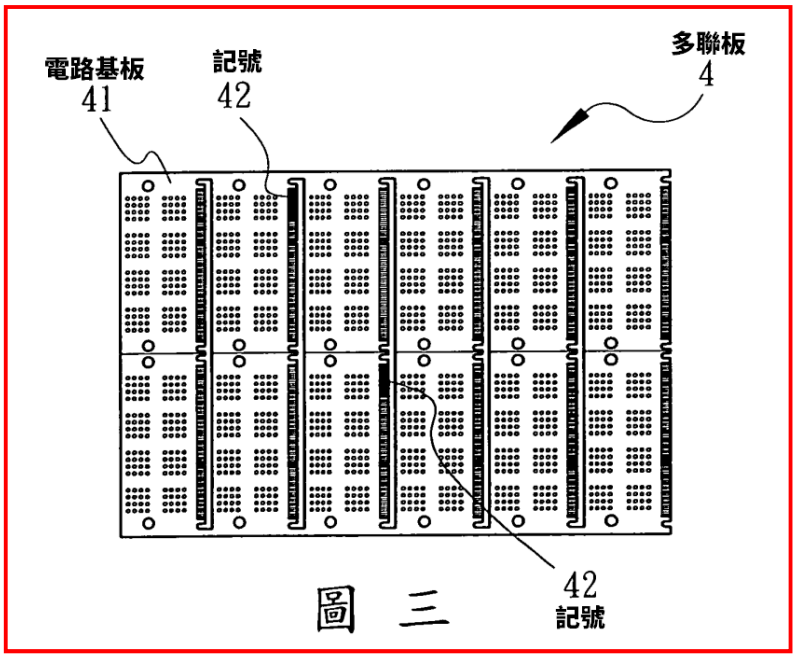


圖 三

系爭專利圖五為多聯板檢測裝置的另一實施步驟流程圖。

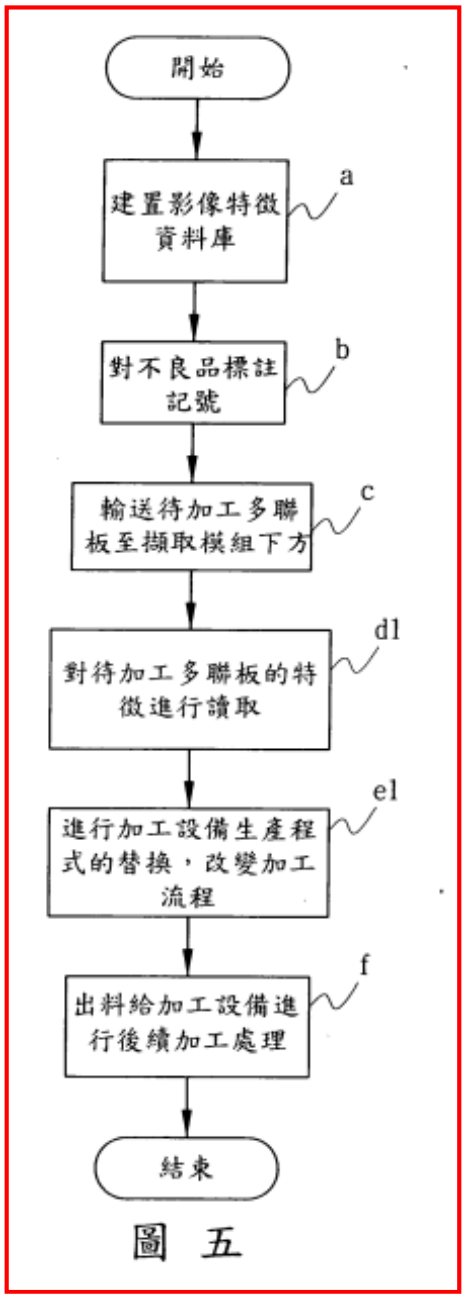
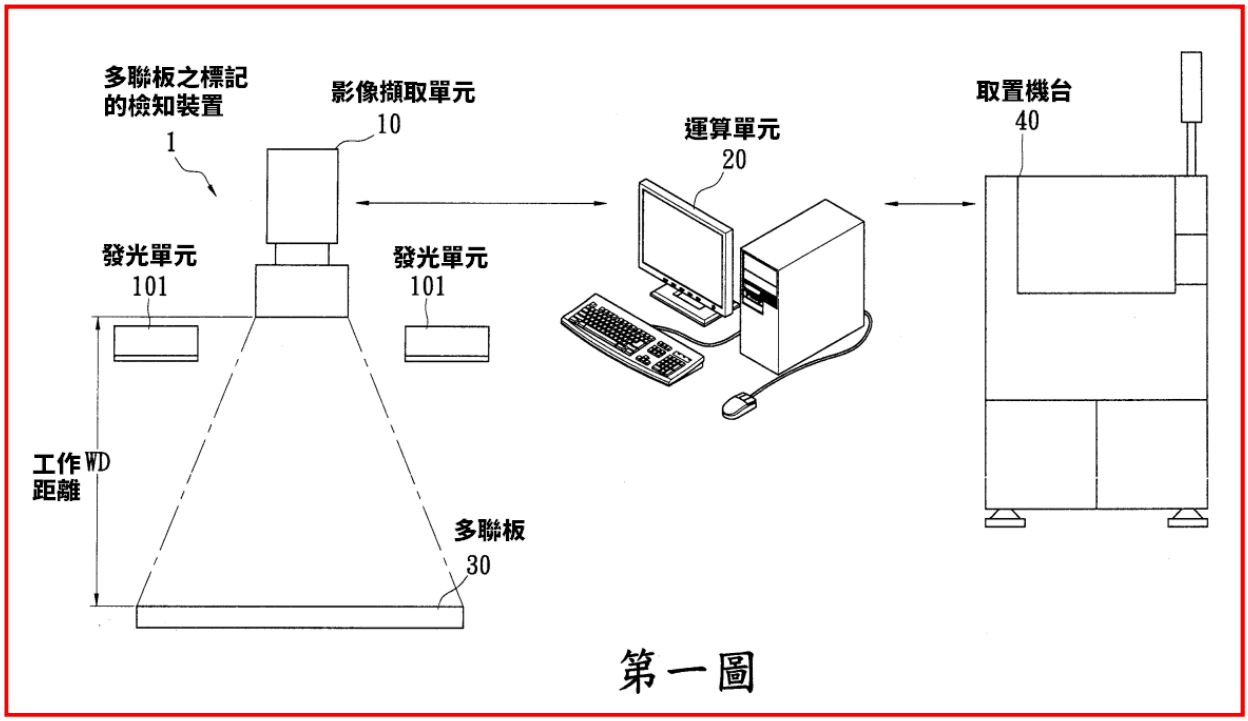


圖 五

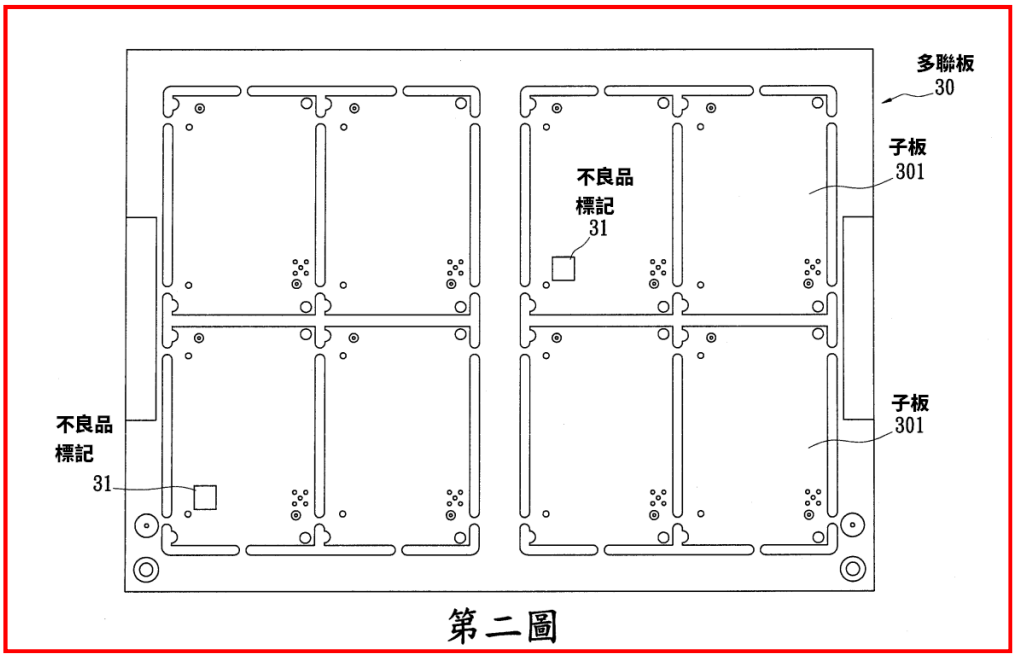
附件二：

證據 2 第一圖為其發明之多聯板之標記的檢知裝置之示意圖



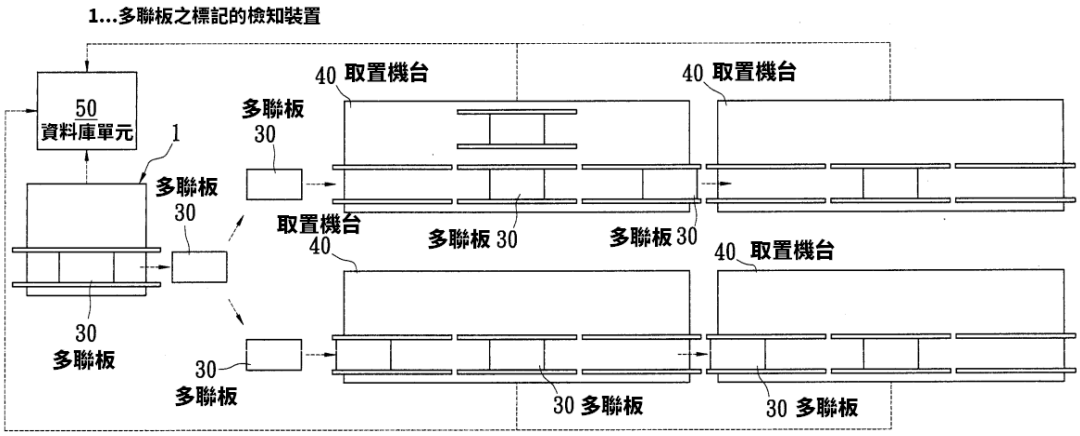
第一圖

證據 2 第二圖為第一種態樣之多聯板之示意圖。



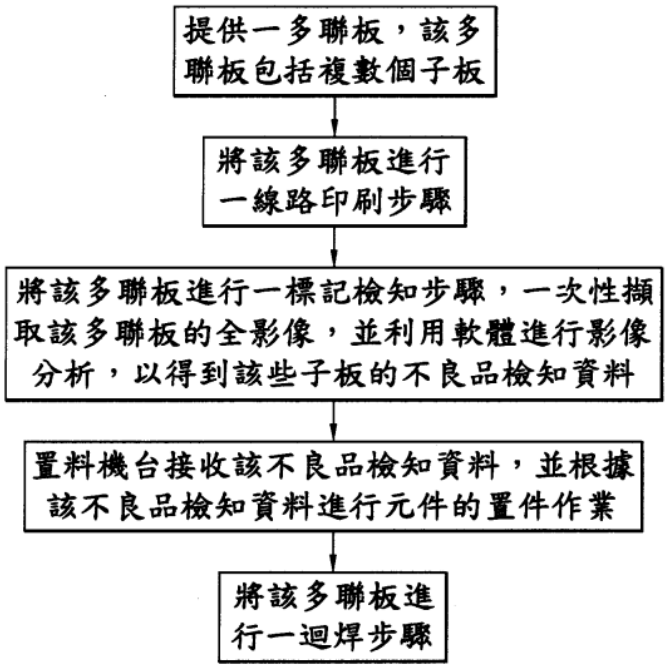
第二圖

證據 2 第七圖為其發明之多聯板之標記的檢知裝置應用於多生產線之示意圖



第七圖

證據 2 第八圖為其發明之多聯板之置件方法之流程圖。



第八圖